

PCB板激光切割机

CM-5xx-TA系列



PCB板激光切割机

产品介绍

利用激光切割PCB电路板等材料上的一项新应用。传统加工方式是采用走刀式分板、冲压式分板、铣刀式分板、铡刀式分板等接触式切割来加工，而采用这些方式分板都有些不足之处：走刀式分板只能进行直线分板，有毛边，有应力；冲压式分板必须专板专模，后期成本高，有应力；铣刀式分板产生大量的粉尘，有应力，不适合薄的电路板的切割；铡刀式分板压力大，应力大，只适合铝基板的分割，加工单一。由于激光具有能量集中，光束质量好，激光束光斑直径小、切缝细、非接触、稳定等居多优点，故采用高功率、稳定、可靠的、寿命长的激光器对任意形状PCB电路板进行精细切割。

产品特点

- 采用高功率、稳定、可靠、可现场更换的激光器，寿命长，激光器的维修及更换激光器成本低；
- 切割复杂图形精度高、性能稳定、性价比更优；
- 精确的运动控制平台，定位精度高，性能更加稳定；
- 切割幅面更大，无需二次定位更快，一次完成切割，操作简单方便，效率更高；
- 专业操作软件，界面友好，操作简单，使用方便，运用自如，严谨的安全设计，一体化高集成设计，安装方便；
- 非接触加工，更能保护电路，切割覆盖膜不发黑，加工边缘光滑漂亮，整体效果堪称完美；
- 采用高精度CCD自动定位，机器精度高，不出现偏位现象；
- 品种转换简单快捷，与形状复杂程度无关，显著降低模具费；
- 加工精度可以达到0.01mm。

应用领域

用于切割，PCB外型切割、分板、钻孔、PCB去铜等功能，适应于手机、耳机、电脑、数码相机等电子产品的PCB电路板的切割、打孔。

样品展示

